

**希荻微电子集团股份有限公司董事会**  
**关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**前 12 个月内购买、出售资产情况的说明**

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“诚芯微”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十四条第一款第（四）项的相关规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

本次交易前 12 个月内，公司购买、出售资产情况如下：

2024 年 7 月，公司通过二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation 收购 Zinitix Co.,Ltd.的控股权（以下简称“前次收购”），前次收购已经公司第二届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 8 月 29 日完成交割，Zinitix Co.,Ltd.成为公司的控股子公司。

根据《重组管理办法》的规定，前次标的交易涉及标的资产与诚芯微均属于集成电路设计相关行业，属于相同或者相近业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的、需披露的重大购买、出售资产交易行为。

特此说明。

（此页无正文，为《希荻微电子集团股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日